

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）、厦门新翼科技实业有限公司（以下简称“新翼科技”）于 2024 年 5 月 21 日签署了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。2024 年 9 月 24 日，公司与厦门半导体、新翼科技、厦门新翼微成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新翼微成”）、厦门产投新翼科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投新翼”）共同签署了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作补充协议》（以下简称“《投资合作补充协议》”）。

上述事项详见公司于 2024 年 5 月 22 日、5 月 23 日、6 月 7 日、8 月 15 日和 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2024-042、临 2024-044、临 2024-048、临 2024-056 和临 2024-065。

二、对外投资进展情况

根据《投资合作协议》及《投资合作补充协议》，公司、厦门半导体、新翼微成和产投新翼已分别完成对项目公司厦门士兰集宏半导体有限公司（以下简称“士兰集宏”）注册资本的认缴。士兰集宏已于近日办理完成对应的工商变更登记。截至本公告披露日，士兰集宏最新的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (亿元)	持股比例 (%)	出资方式
厦门半导体投资集团有限公司	10.00	23.7530	货币
厦门新翼微成投资合伙企业（有限合伙）	11.00	26.1283	货币
厦门产投新翼科技投资合伙企业（有限合伙）	10.50	24.9406	货币
杭州士兰微电子股份有限公司	10.60	25.1781	货币
合计	42.10	100.00	-

根据士兰集宏最新的股权结构，公司对士兰集宏的持股比例由 51.46%降低至 25.1781%，公司将不再将其纳入合并报表范围，将按照权益法核算对士兰集宏的投资，并按照持股比例 25.1781%计算确认投资收益。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年10月1日